

徠卡 DM8000M 顯微鏡



功能/應用

徠卡DM8000 M集成微距模式，可為您提供傳統掃描物鏡視野的四倍。看到更多意味著更快的吞吐量。新的斜紫外線模式結合斜照明與紫外線，使您能夠從任何角度以最高分辨率查看樣品 - 並提高檢測結果的準確性。應用包括晶圓或材料樣品的檢查，過程控制和缺陷分析。

規格

樣品台: 可容納 8 寸晶圓

物鏡: 0.7x (MACRO), 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 150x

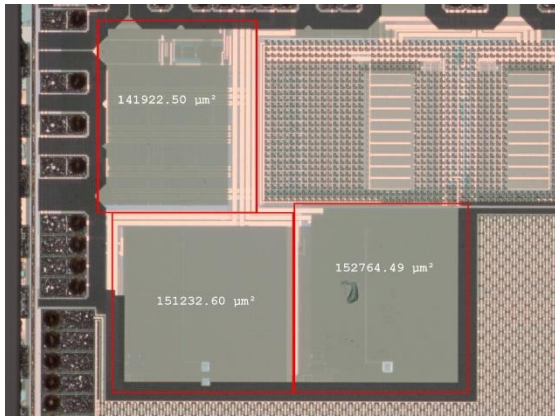
照明: 可見光/紫外光

對比方法: 明場/暗場/衍射干涉對比度

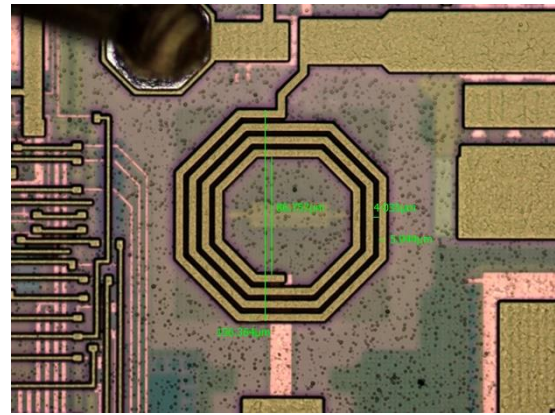
數碼相機: DFC295 (三百萬像素)

軟件: 徠卡 LAS 用於測量及實時 XYZ Builder, 徠卡 MM 用於圖像拼圖

示例應用圖片



電路面積測量



芯片上元件測量

設備製造商網頁

<https://www.leica-microsystems.com/products/light-microscopes/p/leica-dm8000-m/>

Youtube 演示視頻

https://www.youtube.com/watch?v=lvDUz_w7mSs&list=PLB04tRIZiriKo2vGuFjdqNh1kAimMPMEw